

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関  
国際事務局

(43) 国際公開日  
2024年9月19日(19.09.2024)



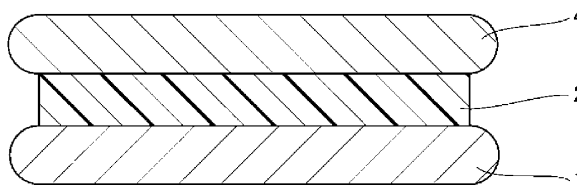
(10) 国際公開番号

WO 2024/190396 A1

- (51) 国際特許分類:  
C09J 183/04 (2006.01) H01L 21/02 (2006.01)  
C09J 11/06 (2006.01) H01L 21/304 (2006.01)  
C09J 183/07 (2006.01) H01L 21/683 (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2024/006983
- (22) 国際出願日: 2024年2月27日(27.02.2024)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:  
特願 2023-037351 2023年3月10日(10.03.2023) JP
- (71) 出願人: 日産化学株式会社(NISSAN CHEMICAL CORPORATION) [JP/JP]; 〒1036119 東京都中央区日本橋二丁目5番1号 Tokyo (JP).
- (72) 発明者: 臼井 友輝(USUI Yuki); 〒9392792 富山県富山市婦中町笹倉635 日産化学株式会社材料科学研究所内 Toyama (JP). 奥野 貴久(OKUNO Takahisa); 〒9392792 富山県富山市婦中町笹倉635 日産化学株式会社材料科学研究所内 Toyama (JP). 柳井 昌樹(YANAI Masaki); 〒9392792 富山県富山市婦中町笹倉635 日産化学株式会社材料科学研究所内 Toyama (JP). 新城 徹也(SHINJO Tetsuya); 〒9392792 富山県富山市婦中町笹倉635 日産化学株式会社材料科学研究所内 Toyama (JP).
- (74) 代理人: 高岡 亮一, 外 (TAKAOKA Ryoichi et al.); 〒1710021 東京都豊島区西池袋5-4-7 池袋トーセイビル5階 高岡 I P特許事務所 Tokyo (JP).
- (81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CV, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IQ, IR, IS, IT, JM, JO, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, MG, MK, MN, MU, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, CV, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SC, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

(54) Title: ADHESIVE COMPOSITION, LAMINATE, AND METHOD FOR PRODUCING PROCESSED SEMICONDUCTOR SUBSTRATE

(54) 発明の名称: 接着剤組成物、積層体、及び加工された半導体基板の製造方法



(57) Abstract: Provided is a curable adhesive composition that is used to form an adhesive layer of a laminate having a semiconductor substrate or an electronic device layer, a support substrate, and the adhesive layer, which is provided between the semiconductor substrate or the electronic device layer and the support substrate, wherein the adhesive composition contains a compound that is devoid of siloxane bonds and has a C5 or higher linear or branched alkyl chain.

(57) 要約: 半導体基板又は電子デバイス層と、支持基板と、前記半導体基板又は前記電子デバイス層と前記支持基板との間に設けられた接着剤層とを有する積層体の前記接着剤層の形成に用いられる、硬化性の接着剤組成物であって、シロキサン結合を有さずかつ炭素原子数5以上の直鎖状又は分岐鎖状のアルキル鎖を有する化合物を含有する、接着剤組成物。

[続葉有]



WO 2024/190396 A1

添付公開書類：

一 国際調査報告（条約第21条(3)）